

2024 年 9 月 2 日

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和
所 在 地 京都府向日市森本町東ノ口 1 - 1
ニデックパーク C 棟

SEMICON TAIWAN 2024 への出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2024 年 9 月 4 日(水)～9 月 6 日(金)に台北南港展示センターで開催される半導体業界における最新技術と革新を展示するアジア最大級の国際展示会「SEMICON TAIWAN 2024」に出展します。



同展示会は、台湾で最も影響力のある半導体関連イベントであり、本年は「BREAKING LIMITS: POWERING THE AI ERA.」をテーマに 1,100 社を超える企業が出展予定です。

今後大きく成長が予想される AI 半導体関連製品においては微細化や実装の複雑化が進んでおり、これに対応した新たな検査技術が求められています。

当社は『TEST SYSTEM ONE STOP SOLUTIONS』をテーマに当社の誇る光学検査技術、電気検査技術、プロービング技術を紹介するほか、先端半導体パッケージ向けにウェハ、チップ、基板、パッケージ全てのプロセスにおいて最先端の検査ソリューションを提案いたします。また、あわせて最近注目を集めているパワー半導体に関しても最先端技術と製品を紹介いたします。

〈出展概要〉

- ・会 期：2024 年 9 月 4 日(水)～9 月 6 日(金)
- ・会場：台湾台北南港展示センター（TaiNEX 2）
- ・ブース：Hall2 Q5652

〈出展内容〉

- ・高精度光学式ウェハ検査装置「NSW シリーズ」
- ・ウェハバンプ対応光学式 2D/3D 検査装置「RWi シリーズ」

- ・最大 60 層まで対応可能「スペーストランスフォーマー-MLO」
- ・高精度、ノイズ影響軽減「2D MEMS プローブカード」
- ・-40℃～200℃計測対応「TC プローブ」
- ・最先端デバイスに対応最小ピッチ 60 μm 「MEMS FLEX プローブカード」
- ・高電圧、高温対応可能「チャンバーヘッド プローブカード」
- ・xEV モデリングシミュレーター「E-Transport Simulator」

今後も当社グループは、検査装置の技術を応用した様々な関連商品の内製展開により、モータの省エネ化を含めたシステム全体の最適化を図ることで電力の消費を抑え、地球環境への負荷低減に貢献する革新的なソリューションを提案していきます。